



2024年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023年11月9日

上場会社名 株式会社 岡本工作機械製作所

上場取引所 東

コード番号 6125 URL <https://www.okamoto.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 石井 常路

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員 管理本部長 (氏名) 高橋 正弥

TEL 027-385-5800

四半期報告書提出予定日 2023年11月10日

配当支払開始予定日

2023年12月6日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第2四半期の連結業績(2023年4月1日～2023年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第2四半期	24,673	10.2	2,908	9.2	2,944	9.0	1,860	0.9
2023年3月期第2四半期	22,382	30.2	2,662	79.5	2,701	69.2	1,878	59.3

(注) 包括利益 2024年3月期第2四半期 2,831百万円 (1.8%) 2023年3月期第2四半期 2,782百万円 (190.9%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第2四半期	396.00	
2023年3月期第2四半期	410.51	409.54

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年3月期第2四半期	55,831	27,216	48.7
2023年3月期	55,098	24,860	45.1

(参考) 自己資本 2024年3月期第2四半期 27,216百万円 2023年3月期 24,860百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期		80.00		100.00	180.00
2024年3月期		100.00			
2024年3月期(予想)				100.00	200.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2024年3月期の連結業績予想(2023年4月1日～2024年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	50,000	9.8	6,000	7.2	5,950	7.2	4,200	4.2	893.89

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年3月期2Q	4,717,895 株	2023年3月期	4,717,895 株
期末自己株式数	2024年3月期2Q	20,202 株	2023年3月期	19,346 株
期中平均株式数(四半期累計)	2024年3月期2Q	4,698,161 株	2023年3月期2Q	4,574,896 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報)	9
(重要な後発事象)	10
3. 補足情報	11
受注及び販売の状況	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、ウクライナ情勢の長期化によるエネルギー価格の高騰、各国でのインフレや金融引き締めを要因とした景気の減速が懸念されるなど、先行きは不透明な状況で推移いたしました。

わが国経済におきましては、新型コロナウイルス感染防止のための行動制限が緩和され、社会経済活動の正常化への動きがみられました。一方で、不安定な国際情勢の中での物価の上昇や、世界的な金融引き締めによる円安の進行もあり、景気の先行きは依然として不透明な状況となっております。

このような状況の中で当社グループは、今期が2年目の中期経営計画「“創” lution 2025 GRIT & Adjust」の目標達成に向け、生産体制の拡充やカスタマーサポート体制の強化など業績向上に努めてまいりました。

その結果、当第2四半期連結累計期間における連結売上高は24,673百万円（前年同期比10.2%増）、営業利益は2,908百万円（前年同期比9.2%増）、経常利益は2,944百万円（前年同期比9.0%増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,860百万円（前年同期比0.9%減）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①工作機械

国内市場におきましては、受注は前年度好調であった大型平面研削盤の受注が落ち着いたことや、ロボット向けの歯車が低調に推移したため前年同期を下回りました。売上につきましては幅広い業種に大型平面研削盤の販売があり前年同期を上回っております。

海外市場におきましては、米国では金利引上げ政策の影響により、中小企業を中心に投資意欲は低下しており、受注、売上共に前年同期を下回る結果となりました。欧州では汎用平面研削盤の販売が増加し売上は前年同期を上回りましたが、ドイツでの景気低迷による先行きへの不安感やイタリアでの補助金政策終了などの影響により受注は減少しております。中国におきましては歯車の需要は低迷したものの、バッテリー金型加工などEV車関連向けの設備投資が活発でロータリー平面研削盤や小型成形研削盤の受注と売上が増加しております。東南アジアでは売上は前年同期より増加しておりますが、自動車関連の回復の遅れから汎用平面研削盤の需要が伸びず、受注は前年同期を下回りました。

以上の結果、売上高は14,348百万円（前年同期比4.0%減）、セグメント利益（営業利益）は446百万円（前年同期比54.7%減）となりました。

②半導体関連装置

半導体市場におきましては、景気の先行きが不透明な中、パソコンやスマートフォンなどの個人向け需要の低迷が続いている影響により、メモリ半導体向けを中心として設備投資の先送りの動きがみられました。一方で、次世代パワー半導体や高周波通信デバイスなどのEVをはじめとする車載向けの半導体では旺盛な需要が継続しております。

このような状況の中で当社グループは、ポリッシュ装置やグラインダーの拡販に向けて、ウェーハ業界向けの新機種の開発やサービス拠点の拡充などの諸施策を進めてまいりました。その結果、売上につきましては、豊富な受注残の生産が進み、国内、東アジア向けにウェーハ生産用のファイナルポリッシャーやパワー半導体向けのグラインダーを販売するなど、前年同期を上回りました。受注につきましては、国内、東アジアの取引先からパワー半導体向けポリッシャーなどの受注を獲得しましたが、景気の先行きへの不安感から設備投資計画の見直しや先送りなどの影響が出ております。

以上の結果、売上高は10,325百万円（前年同期比38.7%増）、セグメント利益（営業利益）は3,078百万円（前年同期比38.7%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①財政状態の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して732百万円増加し、55,831百万円となりました。主な要因は、有価証券が3,000百万円減少した一方で、受取手形、売掛金及び契約資産が2,472百万円、有形固定資産が1,337百万円増加したことによるものであります。

当第2四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して1,624百万円減少し、28,614百万円となりました。主な要因は、電子記録債務が1,023百万円増加した一方で、契約負債が2,692百万円減少したことによるものであります。

また、純資産は、前連結会計年度末と比較して2,356百万円増加し、27,216百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上1,860百万円、配当金の支払い469百万円により1,390百万円増加したこと、及び為替換算調整勘定が946百万円増加したことによるものであります。

これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末の45.1%から48.7%となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して3,761百万円減少し、8,614百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、1,609百万円（前年同期は2,378百万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,930百万円により資金が増加した一方で、売上債権の増加2,288百万円及び契約負債の減少2,819百万円により資金が減少したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、2,250百万円（前年同期は1,312百万円の使用）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,056百万円により資金が減少したことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、228百万円（前年同期は107百万円の獲得）となりました。これは主に、配当金の支払いによる支出466百万円により資金が減少したことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績につきましては、2023年5月12日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,651	7,907
受取手形、売掛金及び契約資産	8,854	11,326
有価証券	4,000	1,000
商品及び製品	5,725	5,620
仕掛品	8,207	8,909
原材料及び貯蔵品	4,313	4,329
その他	652	448
貸倒引当金	△159	△127
流動資産合計	40,245	39,414
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	4,949	5,262
機械装置及び運搬具（純額）	2,991	4,247
その他（純額）	4,794	4,562
有形固定資産合計	12,735	14,072
無形固定資産	277	391
投資その他の資産		
投資有価証券	258	346
退職給付に係る資産	888	918
その他	710	703
貸倒引当金	△16	△16
投資その他の資産合計	1,840	1,951
固定資産合計	14,853	16,416
資産合計	55,098	55,831
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,662	3,331
電子記録債務	3,402	4,425
短期借入金	4,689	3,328
1年内償還予定の社債	12	12
1年内返済予定の長期借入金	467	173
未払法人税等	1,127	1,133
契約負債	11,383	8,690
賞与引当金	531	708
製品保証引当金	49	47
その他	2,911	2,502
流動負債合計	28,237	24,354
固定負債		
社債	12	6
長期借入金	197	2,464
退職給付に係る負債	1,032	1,083
資産除去債務	119	119
その他	640	585
固定負債合計	2,001	4,259
負債合計	30,238	28,614

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,880	4,880
資本剰余金	138	138
利益剰余金	18,619	20,010
自己株式	△83	△88
株主資本合計	23,555	24,940
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5	24
為替換算調整勘定	1,169	2,116
退職給付に係る調整累計額	130	134
その他の包括利益累計額合計	1,304	2,275
純資産合計	24,860	27,216
負債純資産合計	55,098	55,831

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
売上高	22,382	24,673
売上原価	15,304	17,145
売上総利益	7,078	7,527
販売費及び一般管理費	4,415	4,619
営業利益	2,662	2,908
営業外収益		
受取利息	6	33
受取配当金	2	2
助成金収入	6	3
物品売却益	33	40
為替差益	95	17
その他	16	21
営業外収益合計	160	117
営業外費用		
支払利息	42	55
支払手数料	9	11
控除対象外消費税等	25	0
その他	45	14
営業外費用合計	122	81
経常利益	2,701	2,944
特別利益		
固定資産売却益	—	1
特別利益合計	—	1
特別損失		
固定資産処分損	—	15
特別損失合計	—	15
税金等調整前四半期純利益	2,701	2,930
法人税等	823	1,070
四半期純利益	1,878	1,860
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,878	1,860

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
四半期純利益	1,878	1,860
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△4	19
為替換算調整勘定	922	946
退職給付に係る調整額	△13	4
その他の包括利益合計	904	970
四半期包括利益	2,782	2,831
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,782	2,831

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	2,701	2,930
減価償却費	744	859
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	22	48
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△53	△46
賞与引当金の増減額 (△は減少)	167	165
受取利息及び受取配当金	△8	△35
助成金収入	△6	△3
支払利息	42	55
支払手数料	9	11
為替差損益 (△は益)	△33	△95
売上債権の増減額 (△は増加)	884	△2,288
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△2,245	△60
その他の資産の増減額 (△は増加)	321	261
仕入債務の増減額 (△は減少)	428	628
契約負債の増減額 (△は減少)	△75	△2,819
その他の負債の増減額 (△は減少)	173	△86
その他	△0	△21
小計	3,071	△496
利息及び配当金の受取額	8	35
利息の支払額	△41	△53
助成金の受取額	6	3
法人税等の支払額	△666	△1,118
法人税等の還付額	0	20
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,378	△1,609
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△7	△6
有形固定資産の取得による支出	△1,247	△2,056
その他	△57	△187
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,312	△2,250
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	819	△1,455
長期借入れによる収入	—	2,300
長期借入金の返済による支出	△331	△327
社債の償還による支出	—	△6
リース債務の返済による支出	△202	△271
自己株式の取得による支出	△2	△4
手数料の支払による支出	△9	△11
配当金の支払額	△362	△466
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	203	—
その他	△7	14
財務活動によるキャッシュ・フロー	107	△228
現金及び現金同等物に係る換算差額	324	327
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,497	△3,761
現金及び現金同等物の期首残高	12,016	12,375
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,514	8,614

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

I 前第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	工作機械	半導体 関連装置	計		
売上高					
外部顧客への売上高	14,939	7,443	22,382	—	22,382
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	14,939	7,443	22,382	—	22,382
セグメント利益	986	2,218	3,205	△542	2,662

(注) 1. セグメント利益の調整額△542百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第2四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	工作機械	半導体 関連装置	計		
売上高					
外部顧客への売上高	14,348	10,325	24,673	—	24,673
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	14,348	10,325	24,673	—	24,673
セグメント利益	446	3,078	3,524	△616	2,908

(注) 1. セグメント利益の調整額△616百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(重要な後発事象)

(取得による企業結合)

当社は、2023年9月28日開催の取締役会において、大和工機株式会社（以下「大和工機」とする）の全株式を取得し、子会社化することについて決議し、同日付けで株式譲渡契約を締結、2023年11月1日に株式を取得いたしました。

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称：大和工機株式会社

事業の内容：産業機械・生産設備の製作、メンテナンス等

② 企業結合を行った主な理由

当社は、工作機械、半導体関連装置の両分野における「総合砥粒加工機メーカー」として研究・技術開発を推進し、高性能の製品を生産・販売することでお客様の多様なニーズに応えられるよう取り組んでおります。

一方、大和工機は創業以来、産業機械・生産設備の製作及びメンテナンスを主な事業とし、発注先のニーズに沿って半導体製造装置や真空装置などの組立・製造を行っており、複数棟保有する大型のクリーンルーム（洗浄度クラス10000）は九州でも有数の生産設備であることに加え、豊富な納品実績により高い設計・加工技術を蓄積してきております。また、大和工機が本社を構える九州南部は、半導体関連の生産において極めて重要な拠点であります。

この度の株式取得により、大和工機を当社半導体関連装置の新たな製造拠点と開発ラボとして活用し、今後の半導体ニーズに対応してまいります。また、両社の技術・ノウハウをはじめとする事業リソースを組み合わせることで、大和工機の更なる発展に資すると共に、当社の主力事業領域である半導体関連装置の開発・設計・製作・販売にかかる一連の機能強化、提供価値の更なる向上に繋がるものと判断し、今回の株式取得に至りました。

③ 企業結合日

2023年11月1日

④ 企業結合の法的形式

株式取得

⑤ 結合後企業の名称

変更はありません。

⑥ 取得した議決権比率

100%

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	1,199百万円
取得原価		1,199

(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザーに対する報酬・手数料等 50百万円

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

3. 補足情報

受注及び販売の状況

(1) 受注状況

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同期比 (%)
工作機械	13,951	77.4	18,300	89.2
半導体関連装置	3,192	35.0	30,751	85.7
合計	17,143	63.1	49,051	87.0

(2) 販売実績

セグメントの名称	販売高 (百万円)	前年同期比 (%)
工作機械	14,348	96.0
半導体関連装置	10,325	138.7
合計	24,673	110.2